

天津金海通半导体设备股份有限公司

首次公开发行股票网上路演公告

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行1,500.00万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2023]83号文核准。

本次发行的保荐机构（主承销商）为海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”、“海通证券”）。

发行人的股票简称为“金海通”，扩位简称为“金海通股份”，股票代码为“603061”。根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“专用设备制造业（C35）”。

本次发行采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行（以下简称“网上发行”）的方式进行，不进行网下询价和配售。本次发行价格为58.58元/股，本次发行规模为1,500.00万股，其中网上发行数量为1,500.00万股，占本次发行总量的100%。本次发行股份全部为新股，不安排老股转让。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。本次发行前，发行人总股本为4,500.00万股；本次发行后，发行人总股本为6,000.00万股。

本次发行流程、申购、缴款及中止发行等环节的重点内容，敬请投资者关注：

1、本次发行采用直接定价方式，本次发行的股份通过网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售。

2、本次发行价格为58.58元/股。投资者按照本次发行价格于2023年2月20日（T日，申购日）通过上海证券交易所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购，投资者进行网上申购时无需缴付申购资金，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。

3、网上投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

4、网上投资者申购新股摇号中签后，应根据《天津金海通半导体设备股份有限

公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在2023年2月22日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

5、当出现网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

6、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

为便于A股投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发行的保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

1、网上路演时间：2023年2月17日（T-1日，周五）14:00—17:00；

2、网上路演网站：上证路演中心：<http://roadshow.sseinfo.com>

3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。

《天津金海通半导体设备股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要》已于2023年2月16日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。本次发行的招股说明书全文及备查文件可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。

发行人：天津金海通半导体设备股份有限公司
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

2023年2月16日

（本页无正文，为《天津金海通半导体设备股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》之盖章页）

发行人：天津金海通半导体设备股份有限公司



2023年2月16日

（本页无正文，为《天津金海通半导体设备股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》之盖章页）



保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

2013年2月16日